

技术参数

8132

日期：01/2022
上海禧合应用材料



应用介绍

特点

一款单组份导电硅胶粘接剂，加热高温固化，具有较强耐高温性及稳定的高可靠性；适用于热敏感器件芯片粘接固定

粘接材料

金属，塑料/PCB，玻璃，陶瓷等

典型应用

晶振及热敏感器件粘接

固化前特性

特征	数值	测试方法
化学名称	硅胶树脂	
颜色	银灰色	
粘度(cps)	10000-15000	5rpm@25°C, ASTM D-1084
固化条件*	1hrs@150°C	
比重	3.5g/cm ³	
有效期@ -20°C,月	12	

*固化温度是指实际到达胶水表面温度

固化后特性

特征	数值	测试方法
外观	银灰色	
粘接强度 MPa	≥0.3	玻璃+硅片
邵氏硬度 A	93A	
电阻率	4.4*10 ⁻⁴ Ω.cm	IEC 60167:1964, IDT
降解温度	400°C	

可靠性	数值	测试方法
工作温度范围*	-60°C—200°C	

储存和使用方法

产品低于-20°C冷冻环境中保存。使用前需要从冰箱拿出，30ml 室温下解冻 2 小时方可使用；使用胶水时应避免眼睛和皮肤接触，对于接触部位应及时使用肥皂和清水清洗。其他使用注意事项请参考 SDS 文件

注：

本技术参数表所包含的参数是本产品最真实可靠的参数。对于其它机构测得的数据我们无法承担责任。客户最终决定本产品是否适用其工艺，对于生产过程中因使用不当产生的问题无法承担责任。我们建议客户正式使用前请做好各种测试工作。

